

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2015-039

## 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于公司搬迁技改项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、项目概述

公司租赁的位于苏州市工业园区星龙街 29 号苏春工业坊厂房将于 2015 年 12 月 31 日到期，为有效整合资源，提升管理与生产效率，公司拟将苏州工业园区星龙街 428 号苏春工业坊厂区年产能 12 万片晶圆级芯片尺寸封装线整体搬迁至苏州工业园区长阳街 133 号（两地距离约 1.5KM），并在保持既有封装产能不变的基础上，对现有生产线进行改造，以进一步提升生产工艺水平，满足市场与客户需求。

该事项经公司 2015 年 11 月 23 日召开的第二届董事会第七次临时会议审议通过，不涉及关联交易和重大资产重组，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

### 二、项目基本情况

项目名称：年产能12万片晶圆级芯片尺寸封装线搬迁技改项目

项目投资规模：5000 万元人民币

项目实施地点：苏州工业园区长阳街 133 号（公司现有厂区）

项目性质：搬迁、技改

项目实施期：预计一年

### 三、项目实施对上市公司的影响

本项目将根据生产情况逐步完成，项目的实施不会对公司生产经营带来重大

影响。项目完成后，将有效整合公司现有厂区资源，提升公司的生产管理效率与生产能力，降低运营成本，有利于公司业务发展的需要与发展战略的顺利实施。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2015年11月24日